

中国先进封装材料行业市场深度分析及发展趋势与未来展望研究报告(2026-2031版)

报告简介

先进封装材料是用于先进封装工艺，以满足芯片更高性能、更小尺寸、更高集成度等需求的一类关键材料。

先进封装是相对于传统封装而言，通过缩短I/O间距与互联长度、提高I/O密度等方式，有效提升芯片性能，具备高内存带宽、能耗比与性能，可实现多芯片、异质集成及高速互联的封装技术。先进封装材料则是支撑这些先进封装技术实现的基础，包括但不限于封装基板、环氧塑封料、电子胶粘剂、底部填充胶、聚酰亚胺、光刻胶、抛光液和抛光垫、靶材、湿电子化学品等。

例如环氧塑封料是用于半导体封装的一种热固性化学材料，主要成分为环氧树脂、硬化剂、二氧化硅及其他添加剂，能为芯片提供导热、绝缘、耐湿、耐压、支撑等复合功能。底部填充胶是倒装、2.5D/3D封装的关键材料，能缓解芯片、焊料和基板三者因热膨胀系数不匹配产生的内应力，提高芯片抗跌落与热循环可靠性。

2024年中国先进封装材料市场580亿元，需求结构上，ABF载板、EMC&Underfill、PSPI&干膜、电镀液/光刻胶是四大主力赛道。

“前道化”明显，先进封装需要光刻、刻蚀、电镀、CMP，与晶圆厂共用部分设备，台积电/三星/Intel把封装纳入Fab工序，国内中芯、长鑫、粤芯同步布局。高密度、低应力，BumpPitch小于 $20\mu\text{m}$ ，RDL L/S小于 $2\mu\text{m}$ ，要求材料具备小于 $10\text{ppm}/^\circ\text{CCTE}$ 、小于 3.0Dk 的高频低损性能。

国产龙头加速突破：ABF载板：深南电路、珠海越亚、南亚新材；PSPI/BCB：华海诚科、飞凯材料、德邦科技；光刻胶：雅克科技、上海新阳、容大感光；电镀液：艾森半导体、光华科技、上海新阳。

主要痛点：高端材料验证周期长：客户端需12-24个月可靠性考核，Fab认证窗口有限；关键原材料单体/树脂90%依赖日美，供应链安全仍受制约；高端封装基板产能缺口：2024年仅ABF载板缺口即达15%—20

%，成为AIGPU量产瓶颈。

中国先进封装材料行业已完成“技术跟随—产能扩张—高端突破”的三级跳，目前进入“深水区”攻坚期。

本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据国家统计局、商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、工信部、51行业报告网、全国及海外多种相关报纸杂志的基础信息等公布和提供的大量资料和数据，客观、多角度地对中国先进封装材料市场进行了分析研究。报告在总结中国先进封装材料发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国先进封装材料的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。报告资料详实，图表丰富，既有深入的分析，又有直观的比较，为先进封装材料企业在激烈的市场竞争中洞察先机，能准确及时的针对自身环境调整经营策略。本报告也可以用于专精特新“小巨人”申请申报。

报告目录

第一章 行业概述

第一节 先进封装材料定义与分类

一、先进封装材料的基本定义

二、先进封装材料的种类及应用领域

第二节 先进封装材料行业发展历程

一、行业起步与发展阶段

二、当前发展现状及特点

第三节 先进封装材料行业的重要性与作用

一、在电子产品制造中的作用

二、对国家科技进步与产业升级的推动作用

第二章 先进封装材料技术进展

第一节 先进封装材料技术创新趋势

一、新型材料的研发与应用

二、封装技术的创新与突破

第二节 三维封装技术及其材料应用

一、三维封装技术概述

二、三维封装材料的选用与优化

第三节 纳米封装技术及其材料应用

一、纳米封装技术原理

二、纳米封装材料的特性与优势

第三章 市场需求与规模分析

第一节 先进封装材料市场需求现状

一、国内外市场需求概况

二、主要应用领域需求分析

第二节 市场规模与增长趋势

一、历史市场规模回顾

二、未来市场规模预测

第三节 市场供需平衡分析

一、供应现状分析

二、需求与供应的平衡关系

第四章 市场竞争格局

第一节 市场竞争现状

一、主要企业市场份额

二、市场竞争格局分析

第二节 竞争优势与竞争策略

一、企业竞争优势分析

二、企业竞争策略分析

第三节 竞争趋势与未来展望

一、竞争趋势预测

二、未来竞争格局展望

第五章 政策环境与法规标准

第一节 国家政策环境分析

一、国家层面对先进封装材料的支持政策

二、相关政策对行业发展的影响

第二节 法规标准与认证体系

一、国内外相关法规标准概述

二、认证体系与市场准入要求

第六章 行业技术创新与研发

第一节 技术创新体系与机制

一、企业技术创新体系

二、产学研合作机制

第二节 研发投入与成果

一、企业研发投入分析

二、技术创新成果展示

第三节 技术发展趋势与未来方向

一、技术发展趋势预测

二、未来技术发展方向

第七章 产业链分析与上下游关系

第一节 产业链概述

一、产业链构成与特点

二、产业链关键环节分析

第二节 上游供应商分析

一、主要供应商及其产品

二、供应商对行业的影响

第三节 下游应用领域分析

一、主要应用领域概况

二、下游应用对行业的影响

第八章 行业投资与风险分析

第一节 投资机会与潜力

一、行业投资机会分析

二、投资潜力评估

第二节 投资风险与防范

一、主要投资风险分析

二、风险防范措施建议

第九章 环境保护与可持续发展

第一节 环保政策与法规要求

一、国内外环保政策概述

二、先进封装材料的环保要求

第二节 绿色制造与循环经济

一、绿色制造技术应用

二、循环经济与资源利用

第三节 可持续发展战略与措施

一、可持续发展战略制定

二、具体措施与实施方案

第十章 人才培养与教育

第一节 人才需求与现状

一、行业人才需求概况

二、当前人才队伍建设现状

第二节 教育培训与体系建设

一、教育培训资源概述

二、教育培训体系建设

第三节 人才引进与激励机制

一、人才引进政策与措施

二、人才激励机制构建

第十一章 国际贸易与合作

第一节 国际市场概况与趋势

一、国际市场现状与趋势分析

二、国际贸易壁垒与机遇

第二节 国际贸易与合作策略

一、出口市场选择与拓展

二、国际合作项目与模式

第三节 跨国企业在中国市场的表现

一、跨国企业在中国市场的布局

二、跨国企业对中国市场的影响

第十二章 行业标准与质量控制

第一节 行业标准体系构建

一、国内外行业标准概述

二、行业标准体系构建与完善

第二节 质量控制与检测技术

一、质量控制体系建设

二、检测技术与应用

第三节 质量认证与品牌建设

一、质量认证体系与流程

二、品牌建设策略与实施

第十三章 知识产权保护与运用

第一节 知识产权现状与挑战

一、知识产权保护现状

二、知识产权面临的挑战

第二节 知识产权保护策略与措施

一、知识产权保护策略制定

二、具体措施与实施方案

第三节 知识产权运用与价值实现

一、知识产权运营模式

二、知识产权价值实现途径

第十四章 行业发展趋势与未来展望

第一节 技术发展趋势预测

一、技术创新方向预测

二、技术发展趋势分析

第二节 市场需求与规模预测

一、市场需求预测

二、市场规模预测

第三节 行业发展前景与机遇

一、行业发展前景展望

二、行业面临的机遇与挑战

第十五章 结论与建议

第一节 主要结论总结

一、行业发展现状总结

二、技术创新与市场需求分析结论

第二节 发展建议与策略

一、加强技术研发和创新

二、优化产业结构和布局

三、拓展应用领域和市场空间

四、加强质量管理和品牌建设

五、关注环保和可持续发展

图表目录

图表：先进封装核心材料种类及功能特性

图表：主要应用领域需求与驱动因素

图表：2021-2026年全球先进封装材料市场规模(亿元)

图表：2021-2026年中国先进封装材料市场规模(亿元)

图表：2026-2031年全球先进封装材料市场规模(亿元)

图表：2026-2031年中国先进封装材料市场规模(亿元)

图表：2021-2026年中国环氧塑封料(emc)产销量

图表：2021-2026年中国封装基板(abf+bt+玻璃core)产销量

图表：2021-2026年中国pspi/光敏聚酰亚胺(rdl用)产销量

图表：2021-2026年中国临时键合胶(tba)产销量

图表：2021-2026年中国电镀液(tsv+rdl+cupillar)产销量

图表：2021-2026年中国环氧塑封料(emc)主要企业市场份额

图表：2021-2026年中国fc-bga/abf封装基板主要企业市场份额

图表：2021-2026年中国wb-bga/pbga封装基板主要企业市场份额

图表：中国先进封装材料行业产业链

图表：2021-2026年中国先进封装材料行业下游应用领域占比

图表：检测技术全景图

图表：2026-2031年中国先进封装材料市场规模(亿元)

把握投资 决策经营！

咨询订购 请拨打 400-886-7071 (免长途费) Email : kf@51baogao.cn

报告编号 : 2985189

本文地址 : <https://www.51baogao.cn/baogao/20251010/2985189.shtml>

在线订购 : [点击这里](#)